

---

# Obsah

Předmluva . . . . .	9
Seznam hlavních použitých znaků a symbolů . . . . .	10
Úvod . . . . .	13
1. Přehled základů fyziky polovodičů . . . . .	17
1.1. Struktura pevných látek . . . . .	18
1.1.1. Kritéria polovodivých látek . . . . .	22
1.1.2. Elementární polovodiče . . . . .	22
1.1.3. Polovodivé sloučeniny . . . . .	23
1.2. Kvantově mechanická teorie pevných látek . . . . .	27
1.2.1. Model téměř volných elektronů . . . . .	28
1.2.2. Blochov teorém . . . . .	31
1.2.3. Energetické pásy . . . . .	32
1.2.4. Pohyb elektronu v periodickém potenciálu . . . . .	34
1.2.5. Rozdíl mezi kovem, izolantem a polovodičem . . . . .	37
1.2.6. Díry . . . . .	40
1.3. Pásrový model polovodičů . . . . .	41
1.3.1. Krystalová struktura . . . . .	41
1.3.2. Model parabolických pásů . . . . .	45
1.3.3. Pásrová struktura polovodičů s diamantovou mřížkou . . . . .	46
1.3.4. Pásrová struktura polovodičů se sfaleritovou mřížkou . . . . .	49
1.3.5. Polovodiče s wurtzitovou strukturou . . . . .	53
1.3.6. Chalkogenidy olova . . . . .	55
1.3.7. Telur a selen . . . . .	55
1.3.8. Amorfní polovodiče . . . . .	55
1.3.9. Cyklotronová rezonance . . . . .	56
1.4. Model reálného polovodiče . . . . .	57
1.4.1. Vliv teploty . . . . .	57
1.4.2. Kmity lineárního fetězce atomů . . . . .	59
1.4.3. Elektron-fotonová interakce . . . . .	62
1.4.4. Vliv teploty a tlaku na pásovou strukturu . . . . .	63
1.4.5. Vliv elektrického pole na pásovou strukturu . . . . .	64
1.4.6. Vliv magnetického pole na pásovou strukturu . . . . .	65
1.4.7. Vliv příměsi a mřížkových poruch na pásovou strukturu . . . . .	66
1.4.8. Dislokace . . . . .	70
2. Elektrony a díry v termodynamické rovnováze . . . . .	72
2.1. Hustota stavů v dovolených pásech . . . . .	72
2.2. Rovnovážná Fermiho-Diracova rozdělovací funkce . . . . .	73
2.3. Vlastní polovodič . . . . .	74
2.4. Příměsový polovodič . . . . .	79
2.5. Kompenzovaný polovodič . . . . .	82
2.6. Degenerovaný polovodič . . . . .	84
3. Transportní jevy v polovodičích . . . . .	85
3.1. Boltzmannova transportní rovnice . . . . .	86
3.2. Elektrická vodivost . . . . .	88

3.3.	Závislost relaxační doby na energii	91
3.4.	Rozptylové mechanismy	92
3.4.1.	Míříkový rozptyl	92
3.4.2.	Rozptyl na ionizovaných příměsích	95
3.4.3.	Rozptyl na neutrálních příměsích	95
3.4.4.	Jiné druhy rozptylu	96
3.5.	Teplotní závislost pohyblivosti	96
3.6.	Hallův jev a magnetorezistence	100
3.6.1.	Magnetoodporový jev	104
3.7.	Vliv teplotního gradientu na transport nosičů	106
3.7.1.	Termoelektrický Seebeckův jev	107
3.7.2.	Peltierův jev	109
3.7.3.	Termomagnetické jevy	111
3.7.4.	Ettingshausenův jev	111
3.7.5.	Nernstův jev	112
3.7.6.	Righiův-Leducův jev	112
3.8.	Pohyb nosičů proudu v homogenním polovodiči	113
3.8.1.	Vedení proudu ve vakuu	115
3.8.2.	Vedení proudu v izolantu	116
3.8.3.	Vedení proudu v polovodičích při velmi nízkých teplotách	118
3.9.	Vliv vnějších polí na elektrickou vodivost polovodičů	121
3.9.1.	Vliv elektrického pole na pohyblivost nosičů	121
3.9.2.	Vliv elektrického pole na koncentraci volných nosičů proudu	126
3.9.3.	Vliv koncentračního gradientu na elektrickou vodivost polovodičů	129
3.9.4.	Einsteinův vztah	130
	Literatura ke kapitolám 1 až 3	132
4.	Elektrony a díry v nerovnovážném stavu	133
4.1.	Návrat k termodynamické rovnováze	133
4.2.	Ambipolární pohyblivost	135
4.2.1.	Pohyb injektované skupiny minoritních nosičů	136
4.2.2.	Difúzní délka minoritních nosičů	139
4.2.3.	Poissonova rovnice	141
4.3.	Optická absorpcie a generace nadbytečných nosičů	142
4.3.1.	Dovolené přímé přestupy elektronů	143
4.3.2.	Nejpřímé přestupy elektronů	144
4.3.3.	Přestupy mezi výběžky pášů	147
4.3.4.	Excitonová absorpcie	148
4.3.5.	Absorpce volnými elektrony	148
4.4.	Kinetika rekombinačních dějů	149
4.4.1.	Mezipásová rekombinace	150
4.4.2.	Augerova nárazová mezipásová rekombinace	151
4.4.3.	Vliv rekombinačních center	152
4.4.4.	Vliv pastí na rekombinaci	153
4.4.5.	Povrchová rekombinace	155
4.5.	Fotoelektrické vlastnosti polovodičů	156
4.5.1.	Vnitřní fotoelektrický jev	157
4.5.2.	Fotoelektrická vodivost	157
4.5.3.	Mechanismy fotoelektrické vodivosti	158
4.5.4.	Kvantový výtězek	159
4.5.5.	Vlastní fotoelektrická vodivost	160
4.5.6.	Vliv přímého na fotoelektrickou vodivost	161
4.5.7.	Detektory infračerveného záření	162
4.5.8.	Demberův jev	168
4.5.9.	Fotomagnetofotoelektrický jev	169
4.5.10.	Vnitřní fotoelektrický jev v nehomogenních polovodičích	170
4.6.	Elektroluminiscence	171
	Literatura ke kapitole 4	172
5.	Nehomogenní polovodičové systémy	174
5.1.	Slabě nehomogenní polovodič	174
5.2.	Strmý přechod PN	176

5.2.1.	Difúzní napětí	176
5.2.2.	Ideální voltampérová charakteristika	179
5.2.3.	Injekční účinnost	182
5.2.4.	Rozložení pole a potenciálu u strmého přechodu	185
5.2.5.	Kapacita strmého přechodu PN	187
5.3.	Pozvolný přechod PN	188
5.4.	Reálná voltampérová charakteristika	190
5.4.1.	Vliv generace a rekombinace	190
5.4.2.	Vliv vysoké injekce	192
5.4.3.	Difúzní kapacita	193
5.5.	Průraz přechodu PN	193
5.5.1.	Teplelná nestabilita	193
5.5.2.	Zenerův průraz	194
5.5.3.	Lavinový průraz	195
5.6.	Spinací vlastnosti přechodu	198
5.7.	Přechod PP <sup>+</sup> a NN <sup>+</sup> , odporový kontakt	199
5.8.	Heteropřechody a dvouozmenný elektronový plyn	199
5.8.1.	Epitaxe molekulárních svazků	202
5.8.2.	Dvouozmenný elektronový plyn (TDEG).	203
5.8.3.	Bariéry v polikrystalických polovodičích	205
5.9.	Kontakt kov-polovodič	206
5.9.1.	Ideální Schottkyho kontakt	207
5.9.2.	Reálný Schottkyho kontakt	208
5.9.3.	Voltampérová charakteristika Schottkyho kontaktu	211
5.9.4.	Tunelový jev na Schottkyho kontaktu	213
5.9.5.	Realizace odporových kontaktů	215
5.9.6.	Vstřikování menšinových nosičů	216
	Literatura ke kapitole 5	216
6.	Povrchové jevy	218
6.1.	Potenciál, náboj a elektrické pole na povrchu polovodiče	218
6.2.	Ideální struktura MIS	220
6.3.	Reálná struktura MIS	225
6.4.	Určení hustoty povrchových stavů	227
6.4.1.	Zjištění množství pohyblivých iontů pomocí zkoušek BT	229
6.4.2.	Metoda TVS k určení pohyblivých iontů	229
6.4.3.	Kvazistatická metoda C-U	230
6.4.4.	Vodivostní metoda	232
6.4.5.	Určení povrchové generační rychlosti a doby života minoritních nosičů	232
6.4.6.	Zkoumání generačně rekombinačních procesů na rozhraní Si—SiO <sub>2</sub> pomocí diod řízených hradlem	234
6.4.7.	Efektivní hustota stavů	235
6.4.8.	Profil aktivních příměsi	235
6.5.	Stabilizace povrchu	235
6.6.	Vodivost tenkých vrstev polovodičů	237
6.7.	Vodivost tenkých izolačních vrstev	238
	Literatura ke kapitole 6	240
7.	Základní technologie polovodičů a součástek	242
7.1.	Čištění výchozího materiálu	242
7.2.	Příprava monokrystalů	243
7.3.	Selektivní dotování a kontaktování	245
7.4.	Speciální diody	246
7.5.	Tranzistory	249
7.5.1.	Bipolární tranzistory	249
7.5.2.	Unipolární tranzistory	252
7.5.3.	Výkonové tranzistory	253
7.5.4.	Tyristor	254
7.6.	Vrstvové integrované obvody	255
7.7.	Monolitické integrované obvody	256
7.8.	Meze miniaturizace	259
	Literatura ke kapitole 7	261

8.	Některé měřicí metody polovodičů	263
8.1.	Rezistivita	263
8.2.	Hallův jev	265
8.3.	Doba života nadbytečných nosičů	265
8.4.	Měření koncentrace a koncentračního profilu přímčsi	267
8.5.	Měření na strukturách MOS	269
8.6.	Elektronový svazek jako měřicí sonda	270
8.7.	Hluboké přímčsi	273
	Literatura ke kapitole 8	277
	Rejstřík	279